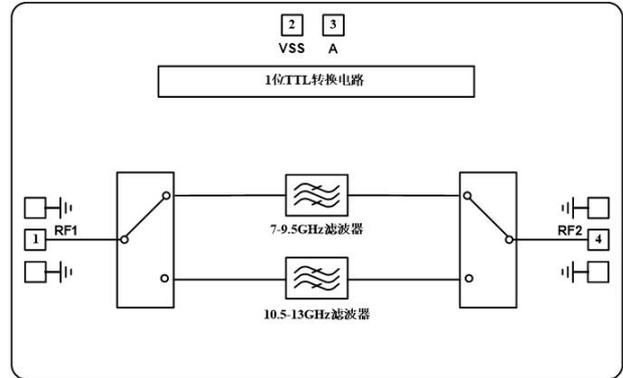




主要特点

- 通道数目: 2
- 通带频率: 7 - 9.5 GHz  
10.5 - 13 GHz
- 插入损耗: 5 dB
- 带内平坦度:  $\pm 0.5$  dB
- 控制电压: 0 / +3.3 V
- 供电: -5 V @ 1 mA
- 芯片尺寸:  $2 \times 1.5 \times 0.1$  mm<sup>3</sup>

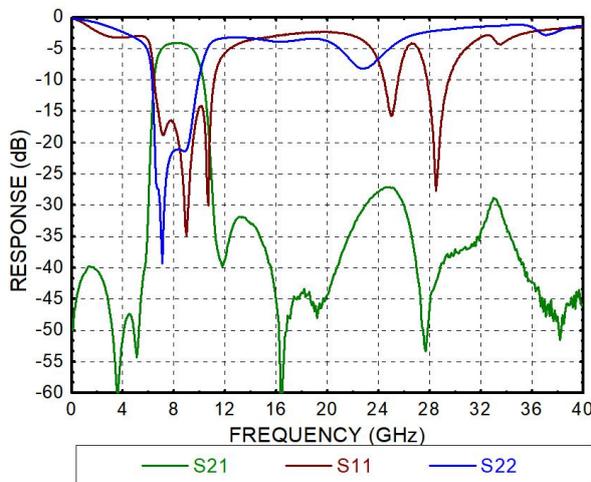
功能框图



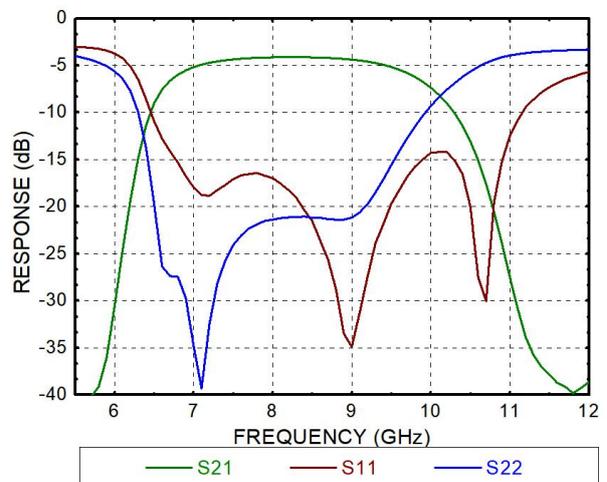
性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $VEE = -5\text{V}$ )

| 参数    | 7-9.5GHz              | 10.5-13GHz              | 单位 |
|-------|-----------------------|-------------------------|----|
| 插入损耗  | 5                     | 5                       | dB |
| 带内平坦度 | $\pm 0.5$             | $\pm 0.5$               | dB |
| 回波损耗  | -18                   | -20                     | dB |
| 带外抑制  | 30@6GHz<br>30@11.1GHz | 30@9.2GHz<br>30@14.8GHz | dB |

7-9.5GHz反射系数

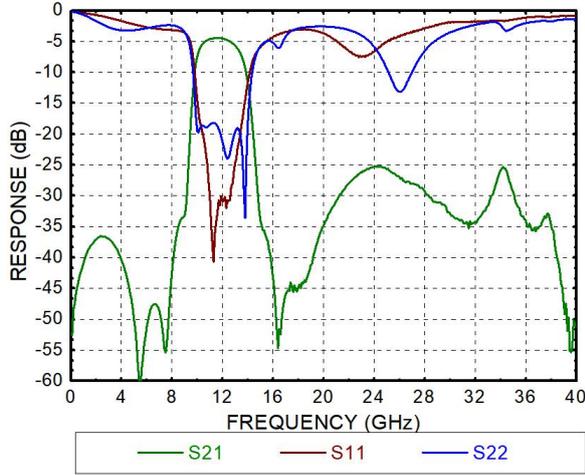


7-9.5GHz反射系数

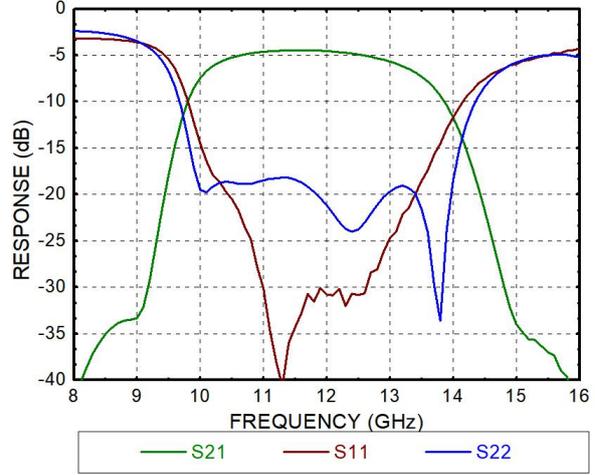




10. 5-13GHz反射系数

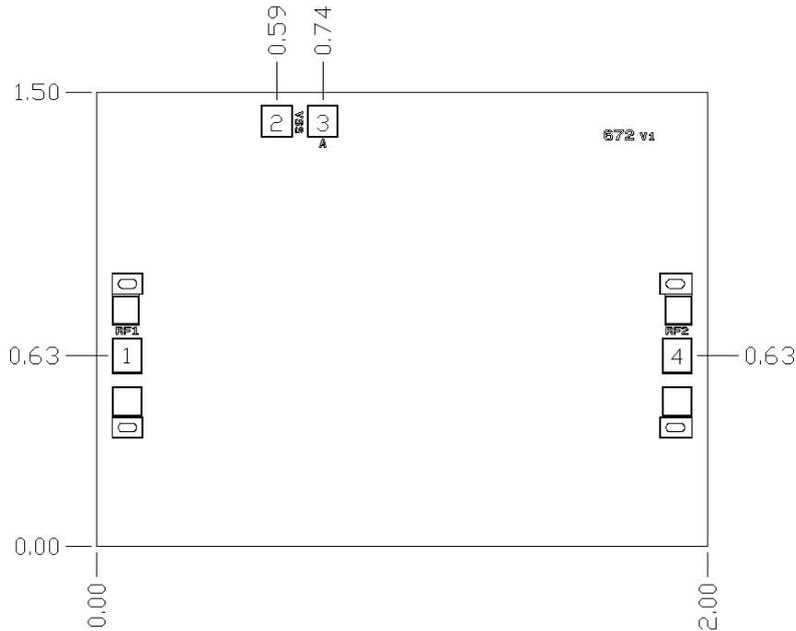


10. 5-13GHz反射系数



物理参数

单位: mm



焊盘描述

| 焊盘序号 | 功能       | 描述                                  |
|------|----------|-------------------------------------|
| 1、4  | RF1, RF2 | 该焊盘是 RF 信号输入输出端, DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm |
| 2    | VSS      | 该焊盘是直流电源输入端, 使用时接-5V 电压             |
| 3    | A        | 该系列焊盘为 TTL 控制电压输入端口, 控制关系见真值表       |
| 芯片背面 | GND      | 芯片背面必须连接至 RF/DC 地                   |

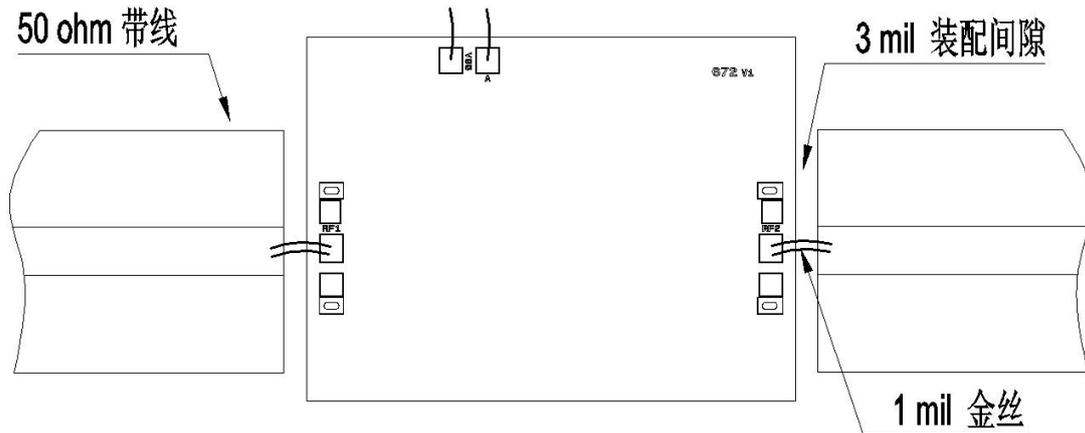


4

控制关系

| 控制频带                               | A |
|------------------------------------|---|
| 7 - 9.5 GHz                        | 0 |
| 10.5 - 13 GHz                      | 1 |
| “0” 电平范围: 0~0.5V; “1” 电平范围: 2.3~5V |   |

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为  $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: -6 V
2. 射频输入功率: +27 dBm
3. 储存温度: -65 ~ +150  $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度: -55 ~ +85  $^{\circ}\text{C}$